

C205

ブロードバンド・プラズマ光学式パターンウェーハ検査装置は、半導体チップの歩留りと信頼性に影響を及ぼす欠陥を発見します。

メリット：

C205は重大欠陥の高感度での検出と分類を提供することにより、自動車用チップメーカーを支援します：

- 新規プロセス、設計ノード、デバイスの特性化と最適化を通じ、R&Dとランプの周期を加速
- チップ品質要件を満たすための欠陥低減戦略を実行
- 信頼性に関連する欠陥に関する正確かつ実用的なデータを提供することにより、チップのオーバーキル率を低減
- 潜在欠陥の見逃しにつながる可能性のあるデザインルールより小さな欠陥を検出および特性化

テクノロジー：

- 波長可変DUV、UV、可視ブロードバンド照明光源
- 選択可能光学アパチャー
- 低ノイズセンサー
- NanoPoint™テクノロジー
- 高度欠陥検出アルゴリズム
- 自動欠陥分類

用途：

- R&Dおよびランプのためのシステムティックな欠陥検出
- プロセス・ウィンドウ・クオリフィケーション（PWQ）
- 継続的改善のためのプロセス変更検証
- 高感度を必要とする重要な工程のインラインモニタリング



市場：

自動車、IoT、5G、民生品、工業（軍事、航空宇宙、医療）用など、デザインルールが比較的緩いデバイスのチップ製造

プラットフォーム：

- カスタマイズ可能な構成
- 拡張可能
- アップグレード可能

ウェーハのサイズ：

- 300mm
- 200mm

詳細情報：

www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-c205